

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 2 月 10 日 (10.02.2005)

PCT

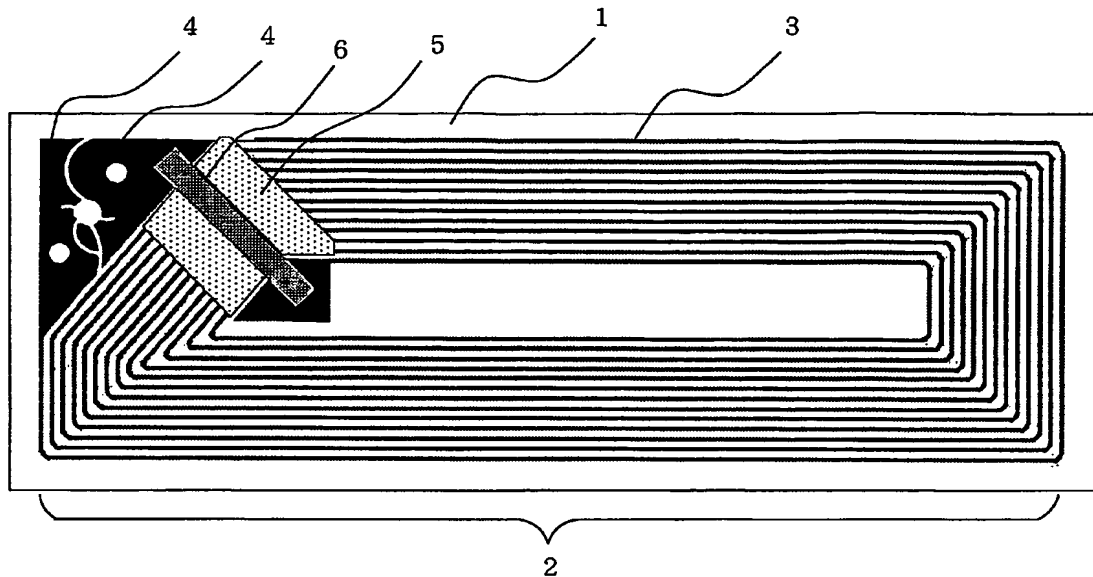
(10) 国際公開番号  
WO 2005/013360 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 23/12 (72) 発明者; および  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/011279 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中田 安一  
(22) 国際出願日: 2004 年 7 月 30 日 (30.07.2004) (NAKATA, Yasukazu) [JP/JP]; 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 松浦 勝良 (MATSUURA, Katsuyoshi) [JP/JP]; 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 松下 大雅 (MATSUSHITA, Taiga) [JP/JP]; 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ: 特願2003-206098 2003 年 8 月 5 日 (05.08.2003) JP (74) 代理人: 折口 信五 (ORIGUCHI, Shingo); 〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目14番7号 西新橋杉浦ビル3階 Tokyo (JP).  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23 Tokyo (JP). (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

/ 続葉有 /

(54) Title: FLIP CHIP MOUNTING SUBSTRATE

(54) 発明の名称: フリップチップ実装用基板



(57) Abstract: The present invention provides a flip chip mounting substrate in which a circuit line and an electronic circuit constituted by two mounting pads connected to both ends of the circuit line is fabricated on one surface of a base sheet, two mounting pads face each other and spaced at a pad interval, and one or more semiconductor mounting paste guide paths are formed in the mounting pads. Voids that might be produced in the semiconductor mounting paste can be reduced when flip-chip-mounting an IC chip on a flip chip mounting substrate.

(57) 要約: 本発明は、基材シートの一方向の表面に、回路線及び該回路線の両末端に接続する2つの実装パッドからなる電子回路が設けられ、2つの実装パッドがパッド間隔を隔てて対向しており、その実装パッドに半導体実装ペースト誘導路が1以上設けられているフリップチップ実装用基板を提供する。本発明のフリップチップ実装用基板は、フリップチップ実装用基板にICチップをフリップチップ実装する際、半導体実装ペースト中に発生するボイドを低減することができる。



WO 2005/013360 A1



DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。